

MIRDC-105-A20R

國內切入高階半導體 檢測設備產業之 商機探究

作者：陳慧娟

執行單位：財團法人金屬工業研究發展中心

中華民國一〇五年十一月

目錄

■ 摘要	1
■ 一、國內外高階半導體檢測設備產業之技術缺口	2
■ 二、國內高階半導體檢測設備產業未來發展商機	4
■ 三、結論與建議	6



國內切入高階半導體檢測設備產業之商機探究

金屬中心 MII 產業分析師 陳慧娟

摘要：

配合全球半導體設備與技術正要蓬勃發展的趨勢下，相關終端廠商為達技術量產化指標，有強烈的成本(包含設備與原物料成本)下降需求，尤其是台積電、日月光等指標性廠商。不同於其他高階製程，檢測技術符合台灣設備的開發能力，因此在相關技術發展的帶動下，台灣本土設備廠商是有機會打破長期被外商所壟斷的局面。只要10%的設備取代率，就有高達300億台幣的商機。相信半導體檢測設備與技術的需求面與未來性，會是國內相關政府單位與產學界值得一同投入開發的藍海市場。

《國內切入高階半導體檢測設備產業之商機探究》

全本電子檔及各章節下載點數，請參考智網公告

電話 | 02-27326517

傳真 | 02-27329133

客服信箱 | itismembers@micmail.iii.org.tw

地址 | 10669 台北市敦化南路二段 216 號 19 樓

匯款資訊 | 收款銀行：兆豐銀行南台北分行 (銀行代碼：017)

戶名：財團法人資訊工業策進會

收款帳號：39205104110018 (共 14 碼)

服務時間 | 星期一~星期五

am 09:00-12:30 pm 13:30-18:00



如欲下載此本產業報告電子檔，

請至智網網站搜尋，即可扣點下載享有電子檔。

ITIS 智網：<http://www.itis.org.tw/>